

半導体デバイスの性能を飛躍的に向上 CFB[®]ソリューション（接合技術）



ディスプレイやスマートグラスは、屋外の視認性が悪い

デジタル社会の進歩は、利便性だけでなく消費電力も増大している

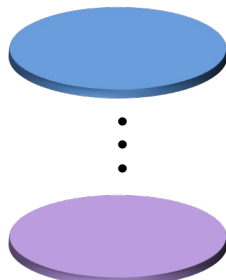


CFB[®]は、単一材料の限界を突破し、デバイス性能向上に貢献します

特長/概要

KP (マテリアル)

高性能な材料



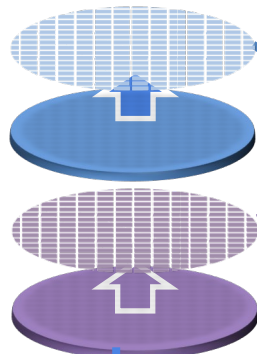
リサイクル

OKI

CFB[®] (接合/集積)

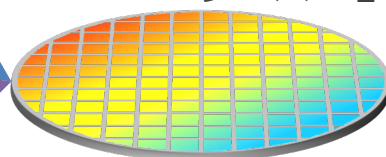
プリンター市場で、17年の量産実績！

「剥離」



「接合」

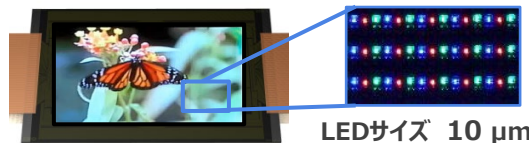
OKIの商品
「CFB[®]ウエハー」



付加価値向上
(性能向上)

利用シーン

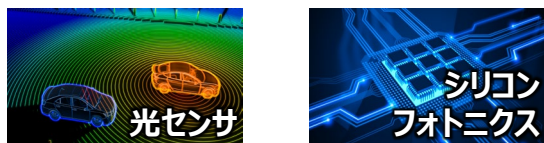
μLEDディスプレイ：高輝度フルカラー



空中ディスプレイ：高視認性



光デバイス：低消費電力



パワーデバイス：低消費電力



■ お問い合わせ

沖電気工業株式会社
イノベーション事業開発センター
ビジネス開発部

<https://www.oki.com/jp/>

■ 参考動画

【OKI 動画ライブラリー】
半導体デバイスの付加価値を向上する『CFBソリューション』
～超音波センサー感度20倍～
<https://video.oki.com/jp/detail/video/6316859558112>

